

INFORMATION MEETING ***2007***

株式会社 村田製作所

電子機器生産台数の増加による需要の拡大



<主要電子機器の生産台数(当社推計値)>

(単位:百万台,%)

		2006年度	2007年度	前期比
携帯電話	販売	914	1,012	+11%
	部品需要	990	1,100	+11%
PC	販売	230	256	+11%
	部品需要	243	268	+10%
液晶テレビ	生産	49	78	+59%
PDPテレビ	生産	11	15	+35%
デジタルカメラ	生産	111	123	+11%

高機能化、デジタル化による部品需要の増加



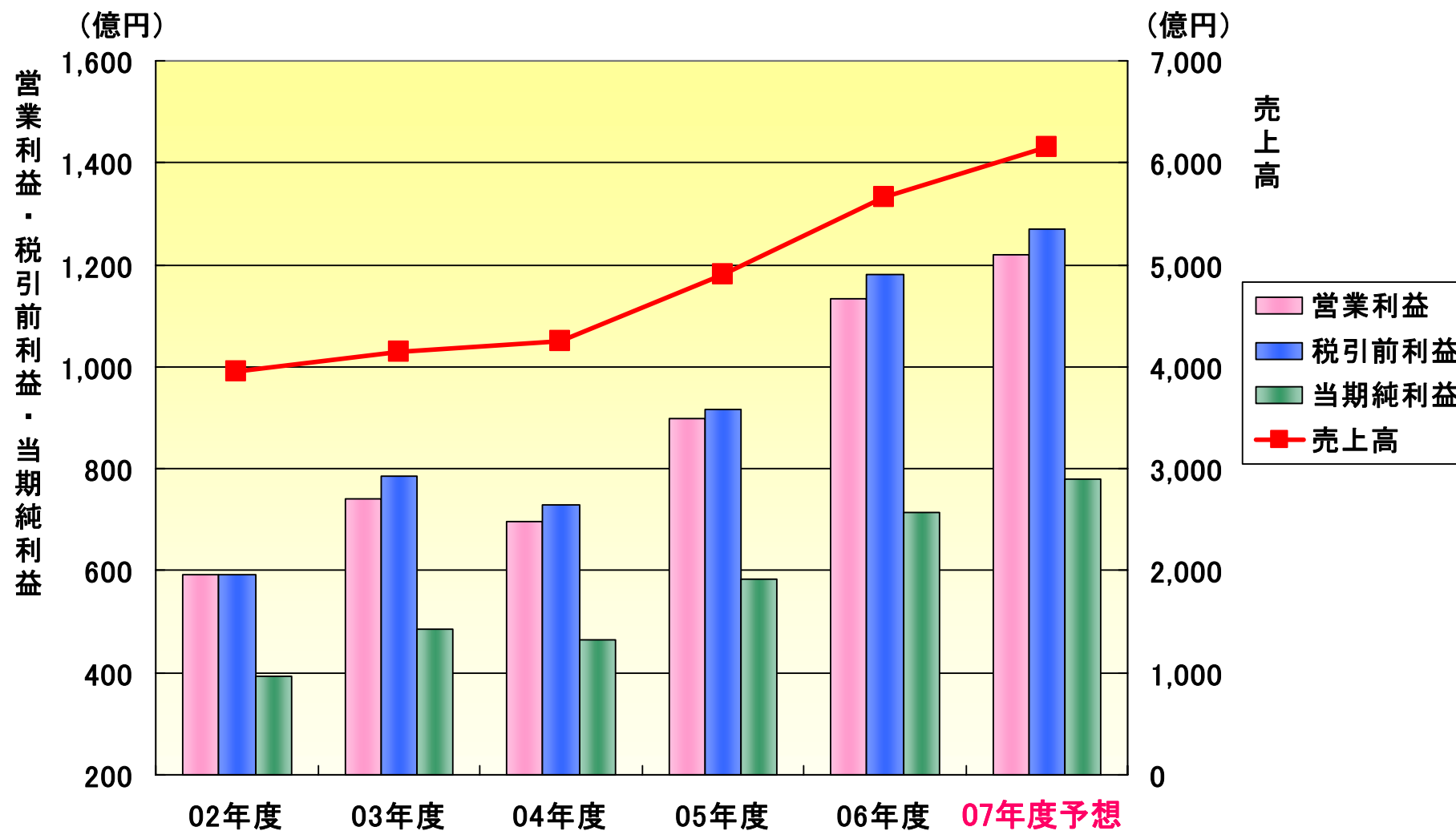
携帯電話	<p>第3世代機の普及、高機能化</p> <ul style="list-style-type: none">・1台あたりに使用される当社の電子部品は1.5倍～2倍に・Bluetooth[®]機能搭載タイプや地上デジタル放送対応など高機能化・マルチバンド化による表面波フィルタの1台あたり使用量増加 (従来の2～3個/台⇒最近では6～7個/台)
デジタルAV機器	<p>薄型テレビ</p> <ul style="list-style-type: none">・32インチ以上のディスプレイでは700～1400個/台のセラミックコンデンサを使用デジタルスチルカメラ・手ブレ補正用機能部品であるジャイロスター[®]の需要拡大
PC	<p>MPUのマルチコア化の進展</p> <ul style="list-style-type: none">・コンデンサの大容量品や用途特化品を中心とした需要増加



電子部品の新たな需要の創出

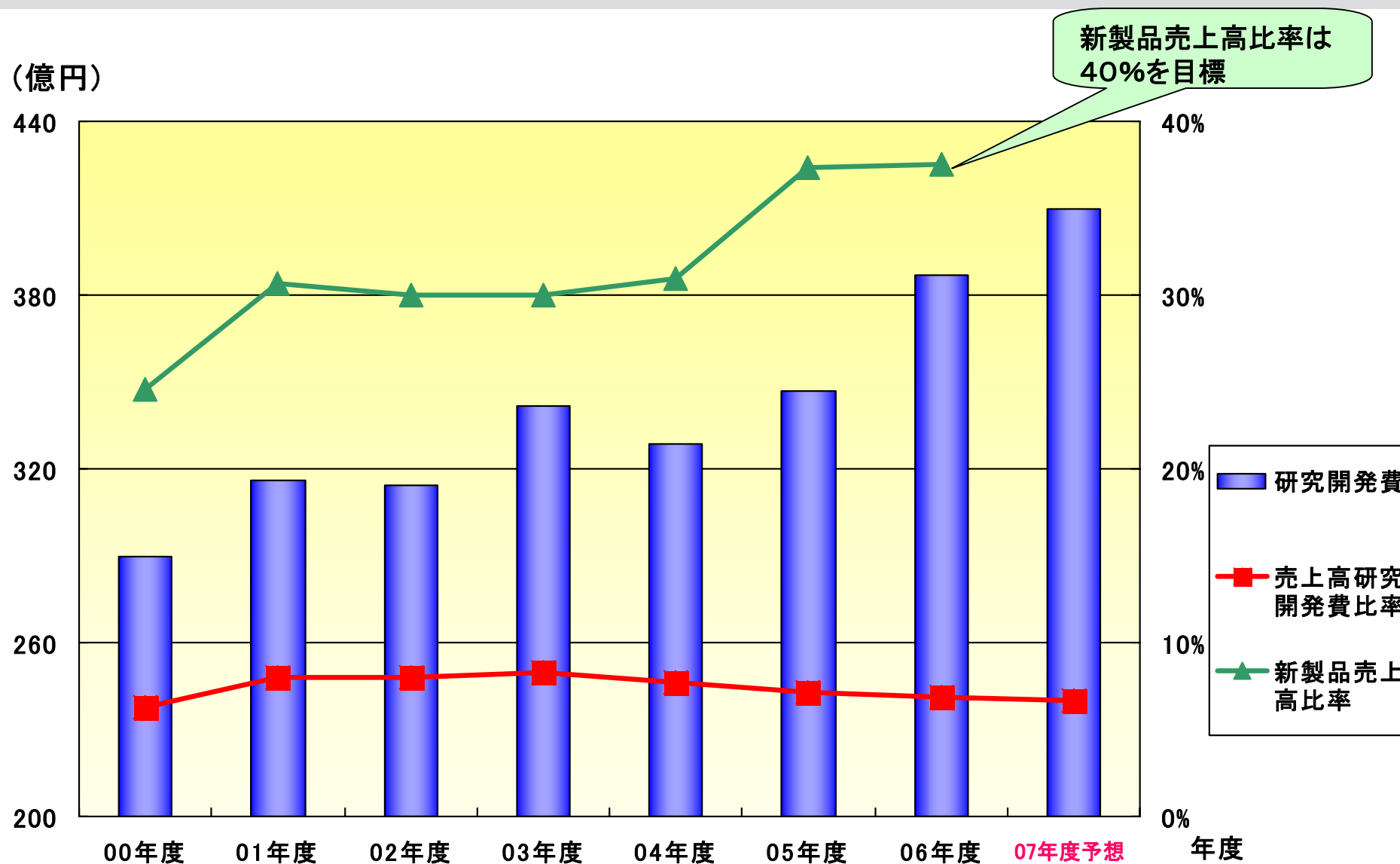
(注) Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の商標です

売上高及び利益の推移



(注)03年度の営業利益には、厚生年金基金代行返上による117億円の増益要因が含まれております。

研究開発費・新製品売上高の推移



業績概況及び見通し



	2005年度 通期	2006年度 通期	前期比	2007年度 通期予想	前期比
	(億円)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
売上高	4,908	5,668	+15.5	6,150	+8.5
営業利益	898	1,134	+26.2	1,220	+7.6
税引前利益	917	1,180	+28.7	1,270	+7.6
当期純利益	584	713	+22.0	780	+9.4

※(%)は前期比伸び率

設備投資



	2006年度 実績	2007年度 予想	増減
	(億円)	(億円)	(億円)
生産設備等	638	510	△128
建物・土地	208	290	+82
研究開発	70	100	+30
その他	81	100	+19
合計	997	1,000	+3

(参考) 2007年度の主な建物への投資

出雲の生産棟(コンデンサ)、金沢の生産棟(表面波フィルタ)、本社の研究開発棟

コンデンサの生産能力増強と需要見通し

当社の生産能力の増強(数量)

- ・2006年度は40%増強
- ・2007年度は9月までにさらに15%増強



総需要予測(当社推定)

需要数量(2005年度→2008年度)

- ・1 μ F未満 1.5倍程度
- ・1 μ F以上 2倍近く

→ 全体で1.6倍程度増加見込み

小型大容量化により急拡大する大容量品

- 1.0 μm の薄層誘電体を用いた
大容量コンデンサの早期量産化
 - ー 1608サイズ10 μF 品、2012サイズ22 μF 品の売上拡大
 - ー 3216サイズ100 μF 品、2012サイズ47 μF 品、
1005サイズ2.2 μF 品の商品化

小型大容量品の製品群を拡充

06年度売上高

- ー 大容量品(1 μF 以上): 前期比+40%程度
- ー 22 μF 以上: 前期比2倍近く

電子機器の高機能化に貢献する小型品

・0603サイズ

- 電子機器の小型化、高機能化とともに売上拡大
- 06年度売上高は前期比+35%程度
- 携帯電話のパワーアンプモジュールや本体ボード、携帯型オーディオ・プレーヤー、ゲーム機での搭載が進む

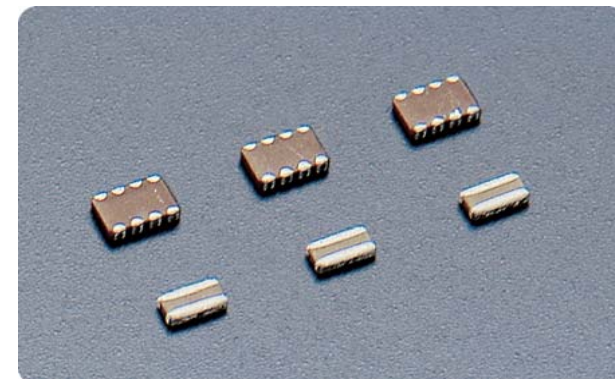
・0402サイズ

- 業界に先駆け商品化
- 携帯電話の
パワーアンプモジュールで採用



用途特化型品の拡大

- 低ESL品は当社が高いシェアを有する
- MPUのデュアルコア化により低ESLコンデンサや大容量コンデンサの需要拡大
- モバイル機器の高密度実装に対応できるアレイ(多端子)品の売上高も拡大
- 06年度売上高は前期比+30%程度



チップ積層セラミックコンデンサ
(低インダクタンスタイプ)

大容量品、小型品、用途特化型品拡大

- ・当社のコンデンサ売上高の6割を占める
- ・製品単価が高く、プロダクトミックスの変化によりコンデンサ全体の平均単価は横ばい



この傾向は続き・・・

07年度の売上高は、大容量品を中心に、コンデンサ全体で前期比+200億円(+10%)程度を計画

機器のデジタル化、高機能化による需要の高まり

電子機器のデジタル化、高機能化に伴う
ノイズ対策の重要性の高まり



- ・当社のノイズ対策部品売上高は値下がりを吸収し、過去数年間にわたり増加
- ・セラミック材料技術や生産技術の展開により高い収益性

ノイズ対策部品（エミフィル、チップコイル）



・チップインダクタ（BLM）

・チップコイル（LQW/LQG/LQP）

— 携帯電話の多機能化や高周波化により売上増加

— 0603サイズ、0402サイズの小型品を商品化



BLM Series



LQW/LQG/LQP Series

・チップ3端子型コンデンサ（NFM）

— AV機器の電源ラインのノイズ対策に特性を発揮



NFM21P Series

・チップコモンモードチョークコイル（DCC）

— 高速インターフェースで発生するノイズを効果的に除去

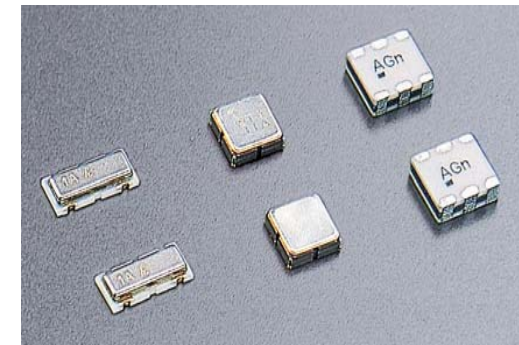


DLP/DLW31S Series

表面波フィルタ



- ー携帯電話の生産台数の拡大
- ーマルチバンド化により1台当たりの使用数量増加
(従来:2~3個/台⇒最近:6~7個/台)
- ーシェア35%まで上昇

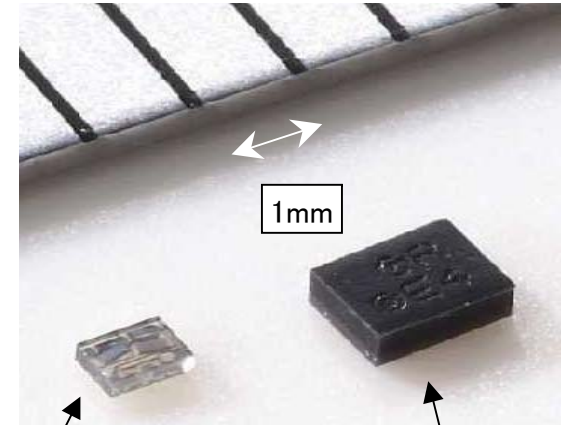


表面波フィルタ

- ・06年度売上高前期比+40%程度
- ・07年度売上高前期比+30%程度を計画

・境界弾性波フィルタ

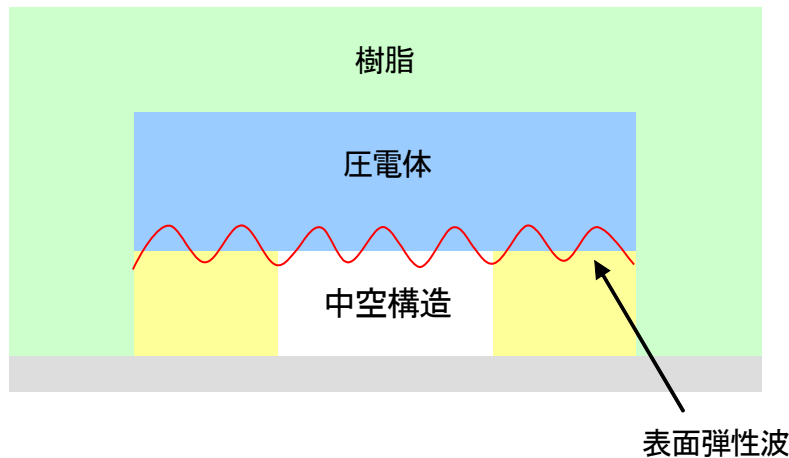
- 新構造を採用
- 当社の表面波フィルタに比べて面積を約1/3に小型化
- 温度・圧力に対する耐性の向上



境界弾性波フィルタ
0.8mm × 0.6mm × 0.365mm

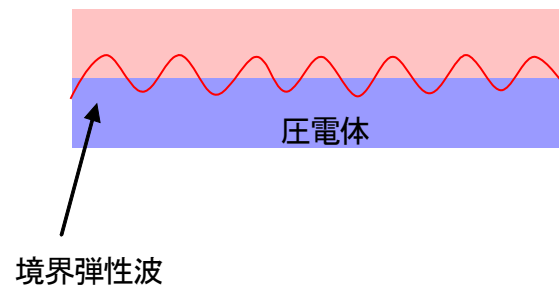
表面波フィルタ
1.35mm × 1.05mm × 0.5mm

<表面波フィルタ>



<境界弾性波フィルタ>

中空構造が不要な境界弾性波フィルタ

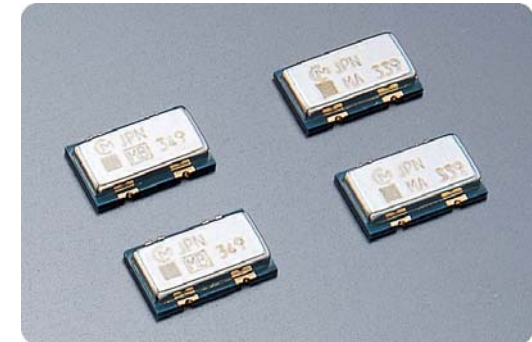


センサ関連製品



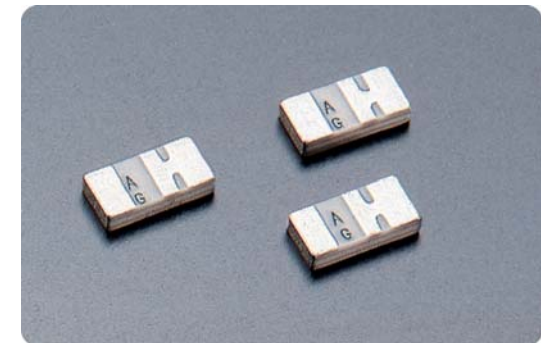
・ジャイロスター[®]

- －手ブレ補正機能付デジタルスチルカメラで需要拡大
- －ゲーム機のコントローラに採用
- －06年度売上高＋15%程度



・ショックセンサ

- －HDD振動検知用
- －HDD生産台数増加



センサ関連製品の広がり

- ・カーナビシステム用MEMSジャイロスター[®]

モジュール製品



・Bluetooth[®] モジュール売上高

2005年度 実績	2006年度 実績	2007年度 計画
450億円	560億円	520億円

得意先の内製化
の動きにより減少

ただし、07年度では無線LANモジュールをあわせた近距離無線通信モジュールの売上高は前期同水準の600億円を計画

モジュール製品の広がり

- ・PCの無線LAN向け多層デバイス・モジュール
- ・携帯電話向け地上デジタル1セグチューナ
- ・薄型テレビ向け電源

米国C&Dテクノロジーズ社 パワー・エレクトロニクス部門買収



- ・取得対価：約85百万US\$
- ・目的：
 - ①当社が保有していない標準電源のラインアップ獲得
 - ②海外マーケットへの本格参入
 - ③DC-DCコンバータで高い市場シェア
 - ④当社の販売網、生産技術、部材調達などとの共有化による競争力強化
- ・売上高：2007年1月期実績 185百万US\$
(約222億円 1US\$=120円換算)
- ・従業員：2007年1月末 1,318名

2015年に売上高1兆円を目標とする長期構想

既存事業の「にじみだし」領域

既存事業を機軸として強化、新商品の投入

→事業領域の拡大

新規事業の開拓

電池、バイオ市場向け電子部品、アンテナなどに着目

→将来の成長性の確保

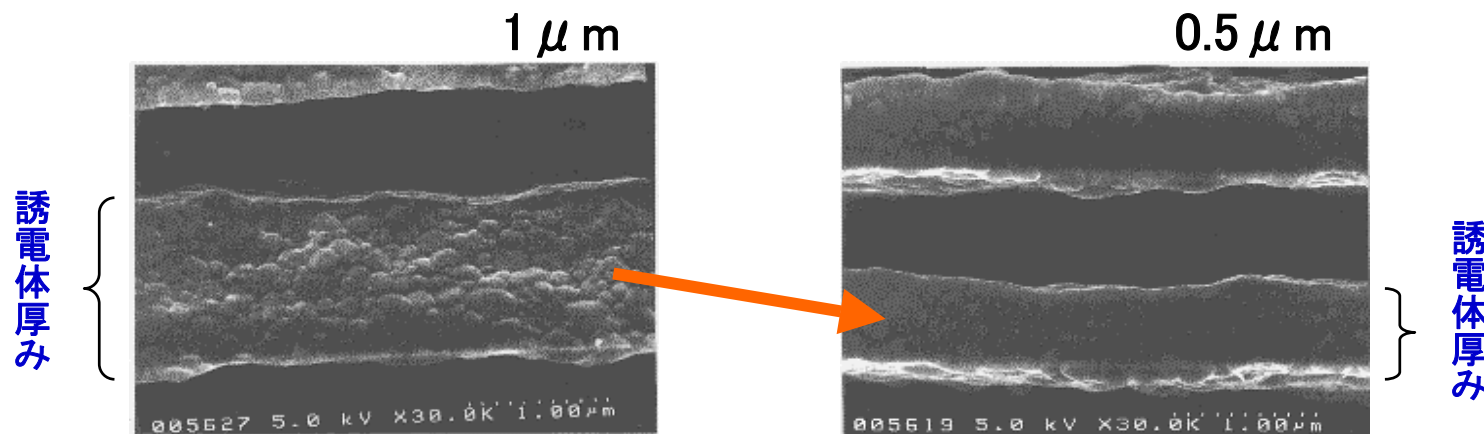
・コンデンサ

—材料技術や積層技術を進化させ、誘電体層を $0.5 \mu\text{m}$ まで薄層化

➡2012サイズ $100 \mu\text{F}$ など小型・大容量コンデンサ

— $100 \mu\text{F}$ 以上の領域も視野に入れた開発

➡技術的には $1,000 \mu\text{F}$ までの超大容量コンデンサが可能とみている



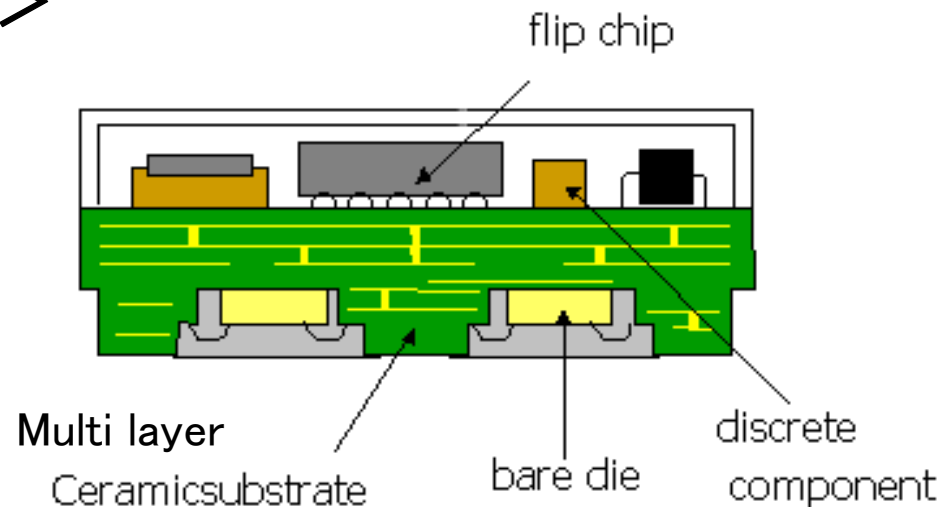
・LTCC技術

—これまで培ったLTCC技術を無線通信分野へ展開

—Sychip社のソフトウェア技術を活用

➔ 新しい通信技術であるUWB、Zigbee、WiMax
などの無線LANモジュールを拡大

<構造図>



・圧電技術

- ーディーゼルエンジン燃料噴射装置
- ーカメラモジュールで使用されるアクチュエータ
- ーモバイル機器向けスピーカ

・ノイズ対策部品

- ー巻線／積層タイプのパワーインダクタ

・微細加工技術

- ーカーナビゲーション用MEMSジャイロスター[®]を商品化

・電池

- ーリチウムイオン2次電池への参入
- ー当社のセラミックで培った
材料技術・生産技術の活用



リチウムイオン2次電池

ターゲット市場

電動工具、電動二輪車

➡最終的にはハイブリッド車

・アンテナ

- ーマルチバンド対応の携帯電話機拡大による需要増加
 - ーセラブリッド[®] (注)を用いたメインアンテナの事業化
- (注) セラミック粉と耐熱性有機材料を混練した複合誘電体材料

・バイオ市場向け電子部品

- ーベンチャー企業との提携
- ー高周波技術を応用した診断機器用電子部品の開発

資本政策



配当・自己株式取得

配当		中間	期末	通期
	2005年度実績	30円	40円	70円
	2006年度実績	40円	50円	90円
	2007年度計画	50円	50円	100円

自己株式取得

2002年～2005年の3年間
1,229億円、2,233万株取得
(取得した自己株式は一部を除き基本的に消却)

当資料に記載されている、当社又は当社グループに関する見通し、計画、方針、戦略、予定、判断などのうち既に確定した事実でない記載は、将来の業績に関する見通しです。将来の業績の見通しは、現時点で入手可能な情報と合理的と判断する一定の前提に基づき当社グループが予測したものです。実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確実な要素により業績見通しと大きく異なる可能性があります、これらの業績見通しに過度に依存しないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の現象、その他の結果に関わらず、当社が業績見通しを常に見直すとは限りません。実際の業績に影響を与えるリスク要因や不確実な要素には、以下のものが含まれます。(1) 当社の事業を取り巻く経済情勢、電子機器及び電子部品の市場動向、需給環境、価格変動、(2) 原材料等の価格変動及び供給不足、(3) 為替レートの変動、(4) 変化の激しい電子部品市場の技術革新に対応できる新製品を安定的に提供し、顧客が満足できる製品やサービスを当社グループが設計、開発し続けていく能力、(5) 当社グループが保有する金融資産の時価の変動、(6) 各国における法規制、諸制度及び社会情勢などの当社グループの事業運営に係る環境の急激な変化、(7) 偶発事象の発生、などです。ただし、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

当資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。

